

Daten und Fakten – Stand 2014

SMT-Bestückung

Maximale Bestückungsleistung	1500 Millionen Bauteile p. a.
Minimalbauteilgröße	Bauform 0201
Maximalbauteilgröße	55 mm ²
Fine-Pitch-Bestückung	bis 0,3 mm
Leiterplattengröße	max. 610 mm x 460 mm

Lötverfahren:

- Dampfphasenlöten
- Konvektionslöten

Alle vollautomatischen Lötverfahren erfolgen unter Stickstoff-Atmosphäre (Schutzgas), und stehen sowohl in bleifreier Technologie als auch in verbleiteter Technologie zur Verfügung.

THT-Bestückung

Maximale Bestückungsleistung	80 Millionen Bauteile p. a.
Automatisierte Bauteilvorbereitung	
Halbautomatische Bestückung mit	
Laser-Bestückungstischen	
Doppelwellenlötanlagen	
Selektivlötanlagen	
Leiterplattengröße	max. 650 mm x 450/500 mm

Alle vollautomatischen Lötverfahren erfolgen unter Stickstoff-Atmosphäre (Schutzgas), und stehen sowohl in bleifreier Technologie als auch in verbleiteter Technologie zur Verfügung.

Leiterplattenschutz

Selektiv-Beschichtungsanlage mit	
Durchlaufbackenofen	400 mm x 500 mm
Vollautomatischer Leiterplattenverguss (Macromelt®)	
in Schmelzgusstechnik	

Kabelkonfektion

Vollautomatische Einzeladerfertigung	
Halbautomatische Kabelfertigung	
Schneid-Klemm-Technik	
Crimptechnik	
Löttechnik	
Halb-/Vollautomatische Klebe- und Vergusstechnik	

Test

▪ In-Circuit-Test	▪ Vollautomatisches Röntgen
▪ Funktions-Test	▪ Automatisch-optische Inspektion
▪ Klima-Test	▪ Kombinations-Test
▪ Burn-In-Test	▪ Schutzklassen-Test
▪ Run-In-Test	▪ Kundenspezifische Tests
▪ Hochspannungs-Test	▪ Schlifffildanalyse für Löt- und
▪ Kabeltester	Crimpverbindungen
▪ Sequentielle Fertigungsprüftechnik	

Zertifizierung

▪ ISO 9001	▪ EN ISO 13485
▪ DIN EN ISO 14001	▪ ISO/TS-16949

Gute Partnerschaft zahlt sich aus

Gute, zuverlässige Partner und Lieferanten sind eine wesentliche Stütze unserer Wettbewerbsfähigkeit. Hier ein Auszug einiger unserer Partner im Bereich Maschinen und Ausstattung:

